

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成26年10月23日(2014.10.23)

【公表番号】特表2014-500335(P2014-500335A)

【公表日】平成26年1月9日(2014.1.9)

【年通号数】公開・登録公報2014-001

【出願番号】特願2013-531673(P2013-531673)

【国際特許分類】

C 0 8 L	23/06	(2006.01)
C 0 8 J	3/20	(2006.01)
H 0 1 B	9/00	(2006.01)
H 0 1 B	7/02	(2006.01)
H 0 1 B	3/44	(2006.01)
H 0 1 B	3/30	(2006.01)
B 2 9 C	47/02	(2006.01)
B 2 9 K	23/00	(2006.01)
B 2 9 L	9/00	(2006.01)

【F I】

C 0 8 L	23/06	
C 0 8 J	3/20	C E S Z
H 0 1 B	9/00	A
H 0 1 B	7/02	Z
H 0 1 B	3/44	F
H 0 1 B	3/30	P
B 2 9 C	47/02	
B 2 9 K	23:00	
B 2 9 L	9:00	

【手続補正書】

【提出日】平成26年9月4日(2014.9.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

低密度ポリエチレン(LDPE)及び少量の高密度ポリエチレン(HDPE)を含むポリマー組成物を、少なくともHDPEの融解温度まで加熱することと、

0.1 / min から 20 / minまでの冷却速度で、加熱されたポリマー組成物を制御冷却することと、

ポリマー組成物を形成することと

を含む方法。

【請求項2】

AC絶縁破壊強度が、ASTM D 149に従って85マイクロメートルの薄膜上で測定して、170kV/mm超であるポリマー組成物を形成することを含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

低密度ポリエチレン(LDPE)及び少量の高密度ポリエチレン(HDPE)を含むポ

リマー組成物を H D P E の融解温度を超える温度まで加熱することと、
伝導体上に加熱されたポリマー組成物を押出すことと、
0 . 1 / m i n から 2 0 / m i n の間の冷却速度で伝導体上に位置付けられた加熱されたポリマー組成物を制御冷却することと、
伝導体上に、ポリマー組成物を含む被覆膜を形成することと
を含む、被覆伝導体を製造する方法。

【請求項 4】

伝導体と、
伝導体上の被覆膜であって、大部分の量の低密度ポリエチレン(L D P E)の中に分散した少量の高密度ポリエチレン(H D P E)のラメラを含むポリマー組成物を含む被覆膜とを含む、被覆伝導体。

【請求項 5】

ポリマー組成物が、A S T M D 1 4 9に従って 8 5 マイクロメートルの薄膜上で測定して、1 7 0 k V / m m超の A C 絶縁破壊強度を有する、請求項 4 に記載の被覆伝導体。